

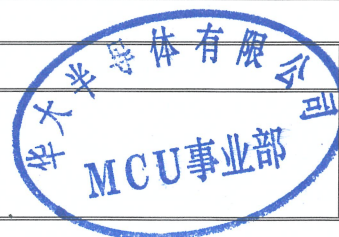
## 西安华天 QFN 封装测试场地变更的通知

客户名称	ALL	联系人	NA
------	-----	-----	----

受影响产品	商业名称	物料编码
	HC32F005C6UA-SFN20TRX	2F005C6B-0053C0SN1R
	HC32F005C6UA-ZFN20TR	2F005C60-0053C0ZN1R
	HC32F003C4UA-SFN20TR	2F003C40-0053C0SN1R
	HC32F003C4UA-SFN20TR	2F003C40-0053C0SN2R
	HC32F005C6UA-SFN20TR	2F005C60-0053C0SN1R
	HC32L110C6UA-SFN20TR	2L110C60-0053C0SN1R
	HC32L110C4UA-SFN20TR	2L110C40-0053C0SN1R
	HC32L130F8UA-QFN32TR	2L130F80-0063B0QN1R
	HC32L130F8UA-QFN32	2L130F80-0063B0QN1T
	HC32L130F8UA-QFN32TR	2L130F80-0063B0QN2R
	HC32F030F8UA-QN32TR	2F030F80-0063B0QM1R
	HC32L051F8UA-QN32TR	2L051F80-0063B0QM1R
	HC32L130F8UA-QFN32CLM32Q	2L130F80-0063B0C61T
	HC32L130F8UA-QFN32TR	2L130F80-0063B0C81R

变更原因描述	西安华天增加封装和测试产能。												
变更方法描述	<p>框架类 Package<math>\geq</math>03*03 产品封装场地从“制造一部”转移至“制造三部”加工封装，测试及包装工序从“测试一部”转移至“测试二部”加工。</p> <p>变更对比如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>方面</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人</td> <td>使用相同培训流程考核持证上岗作业，员工质量意识及熟练度没有区别</td> </tr> <tr> <td>机</td> <td>变更后设备型号相同或采用更新型号</td> </tr> <tr> <td>料</td> <td>BOM 相同</td> </tr> <tr> <td>法</td> <td>使用相同QC文件，测量方法相同</td> </tr> <tr> <td>环</td> <td>温湿度相同，洁净度相同</td> </tr> </tbody> </table>	方面	备注	人	使用相同培训流程考核持证上岗作业，员工质量意识及熟练度没有区别	机	变更后设备型号相同或采用更新型号	料	BOM 相同	法	使用相同QC文件，测量方法相同	环	温湿度相同，洁净度相同
方面	备注												
人	使用相同培训流程考核持证上岗作业，员工质量意识及熟练度没有区别												
机	变更后设备型号相同或采用更新型号												
料	BOM 相同												
法	使用相同QC文件，测量方法相同												
环	温湿度相同，洁净度相同												
变更生效日期或产品 Date Code 说明： <b>2021/7/8</b> 变更开始生效													

发行人	严锋	发行日期	2021/4/8
华大半导体 MCU 事业部工程部经理签署：孙少军		日期：2021.4.29	



客户	部确认意见:
签署:	日期:

✧ 以上，特此通知，如果您有任何意见或建议，请随时与我司销售部门联系。 ✧